附件一



**114學年度半導體學士後專班招生-國外學歷切結書**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 准考證號 | (考生勿填) | 考生簽章 |  |
| 身分證字號 |  | 聯絡電話 | 住家：( )  行動： |
| E-mail |  | | |
| 通訊地址 |  | | |

**【請將本切結書，連同經由驗證之證明文件，於報名時一併上傳】**

　　本人報考義守大學114學年度半導體學士後專班入學招生考試，所持國外學歷證件確為教育部認可，經駐外單位驗證屬實，請准予上傳下列證明文件報考，並保證於錄取報到時，繳交下列正本資料：

1. 經駐外單位驗證之國外學歷證件(非英文者請另附中譯本)。
2. 經駐外單位驗證之國外學歷歷年成績證明(非英文者請另附中譯本)。
3. 內政部移民署核發之入出境紀錄證明。

**本人同意於錄取報到時繳交上列學歷正本，所附各項文件如經 貴校查驗、查證為不符合「大學辦理國外學歷採認辦法」規定，則取消錄取資格(已入學者開除學籍)，亦不發給任何學歷證件，絕無異議，特此聲明。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 學校國別 |  | 地點(州別) |  |
| 就讀學校外文名稱 |  | | |
| 就讀學校之中文譯名 |  | | |
| 就讀學系之中文譯名 |  | | |
| 就讀學校就讀期間 | 年 月至 年 月 合計 年 個月 | | |

此致

義守大學招生委員會

中 華 民 國 年 　 月 日